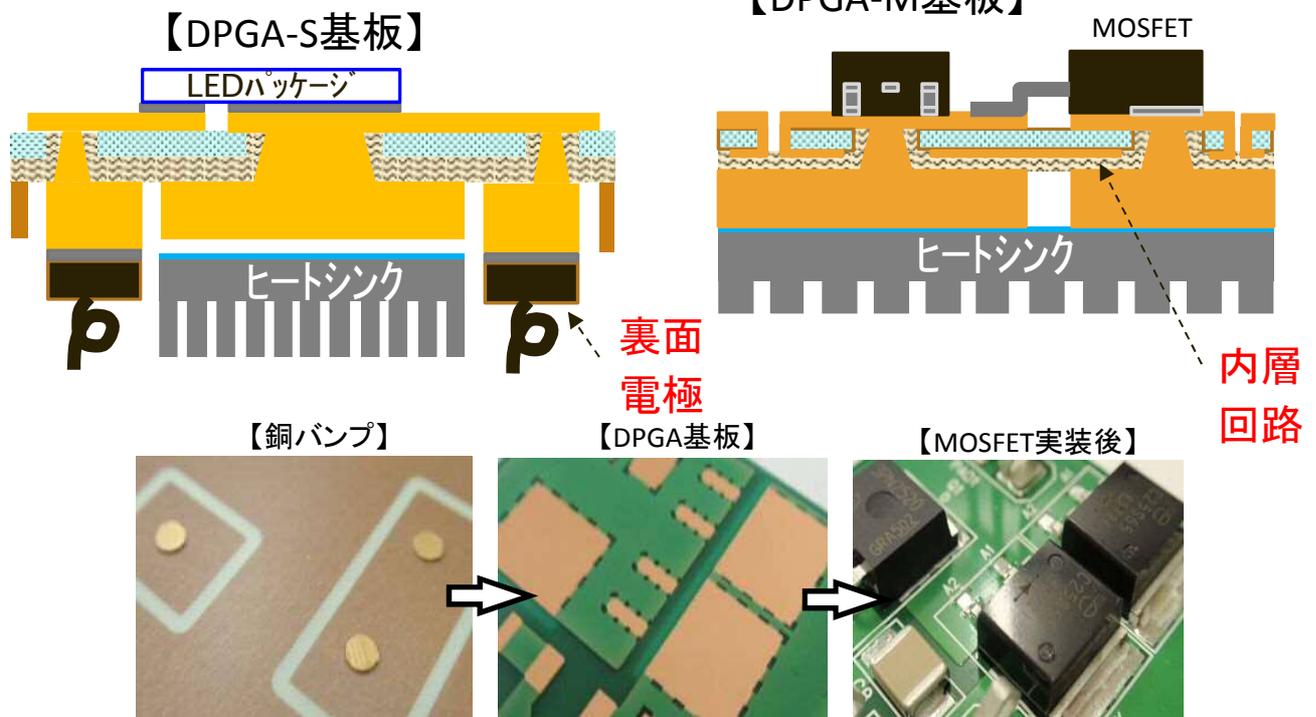


ひとわざ(一技)名: 高放熱基板・DPGA-S/M

1. 概要(200字目安)

従来は、LEDの放熱用途を中心に拡販してきましたが、今回、新たな高放熱基板を開発いたしました。既存の放熱基板として、アルミベース基板・銅ベース基板・銅バンプ入りDPGA基板と各種のレパートリーがありますが、今回はこのDPGA基板の進化版である、DPGA-S基板、DPGA-M基板を出展いたします。この基板を使用することにより、パワー半導体部品の放熱も実現しております。

写真・図(要点説明)



2. 企業概況

フリガナ	カブシキガイシャダイワコウギョウ		フリガナ	ヨシムラ エイジ			
会社名	株式会社ダイワ工業		代表者名	吉村 栄二			
			フリガナ 窓口担当	トミサワ タツヤ 富澤 達也			
事業内容	プリント配線板 製造・販売		URL	http://www.daiwa-kg.co.jp/			
主要製品	プリント配線板 (リジット基板・メタルベース基板・特殊高放熱基板)						
フリガナ 住所	ナガノケンオカヤシシメイチヨウ4チヨウメ1-25 〒394-0004 長野県岡谷市神明町4丁目1-25						
電話/FAX	0266-22-5758 / 0266-23-7324		E-mail	sales@daiwa-kg.co.jp			
資本金(百万円)	95	設立年月日	1967年	売上(百万円)	800	従業員数	60

特記事項(①特許取得・各種認証等取得状況②提供できる価値及び応用分野③医療分野参入(取引)実績 他

- ① ISO9001:2000年1月取得
ISO14001:2008年11月取得
- ② パワー半導体/ハイパワーLEDなどの放熱問題でお困りの方はご相談ください。
- ③ 手術用照明器具、血液分析装置など、各種医療機器に搭載される基板製造実績有ります。